

Polish Grinder

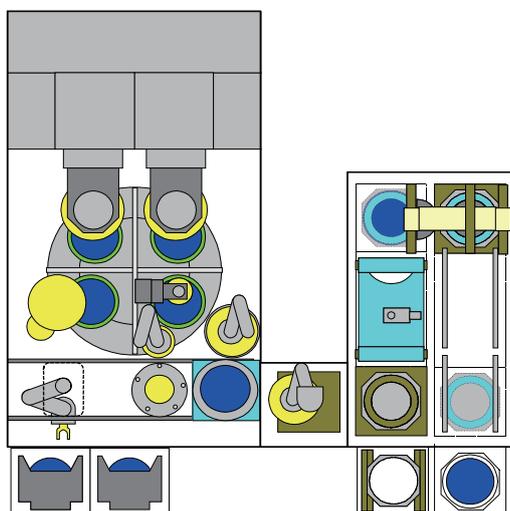
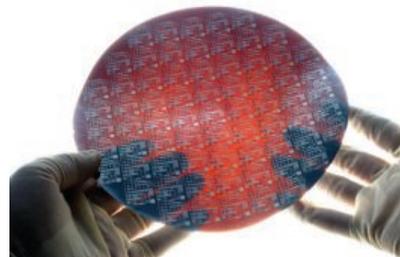
PG3000RMX



株式会社東京精密

Polish grinders

ウェーハ厚さ 15 ミクロンを高スループットで量産可能なシステム・インテグレーション、ポリッシュ・グラインダ PG3000RMX



薄片化

25 ミクロンのウェーハ厚さが加工できるアプリケーションと搬送できるシステムを備えて実現しました。

仕上げの多様化

ウェットポリッシュによるストレスリリースのみならず、ゲッターリングに必要な EGF などのアプリケーションを提供できます。

拡張性

ML DICER とのシステムインテグレーションなど、より高品質なアプリケーションを提供できます。

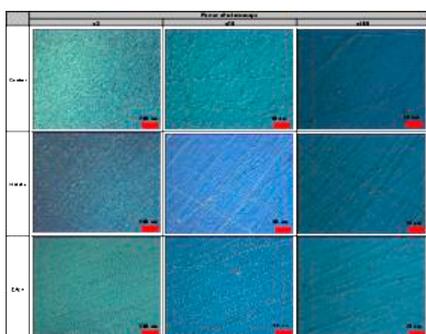
Various option



■ NCIG (Non Contact Inprocess Gauge) 自動 TTV 機能搭載

非接触タイプのウェーハ厚さゲージを搭載する事が可能です。

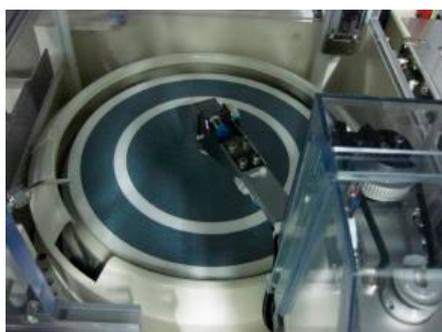
直接シリコンウェーハの厚さのみを計測してインプロセスで厚さ制御する事ができるので、表面保護テープの厚さバラツキや、WSSなどの基盤及び接着層の厚さバラツキの影響を受けずに、仕上げ厚さの精度向上が達成できます。また、削った後のウェーハ形状を測定する自動 TTV 補正機能を搭載することで安定したウェーハを提供いたします。



■ EGF (Extrinsic Gettering Function)

ウェーハ裏面に金属イオンを捕捉する微小な欠陥を付与する事が可能です。

ウェーハの厚さが薄くなるとシリコンウェーハ内部にある IG 層 (Intrinsic Gettering) が除去されてしまう為、金属イオンを捕捉する欠陥層が不足します。チップの抗折強度を維持しながらウェーハ裏面に微小欠陥を付与する事で EG 層を形成する事ができます。



■ WCS (Wafer Cleaning System)

多様なウェーハ洗浄システムを提供できます。ウェーハ裏面のパーティクルの除去やコンタミネーションの除去は、デバイスやパッケージの観点から年々要求度合いが増しています。スクラビングブラシ洗浄、メガソニック洗浄、SC1 洗浄など多様なウェーハ洗浄を用いて要求に見合った結果を得る事ができます。



■ ML DICER Inline System (Integration System)

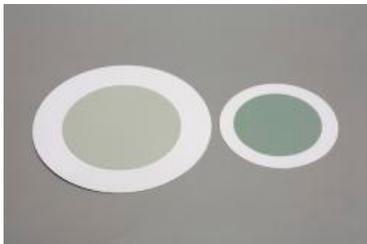
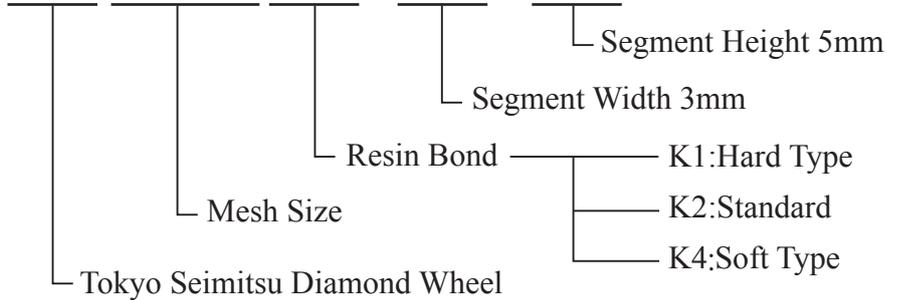
ML DICER とのインテグレーションシステムを提供できます。特にウェーハが薄くなると、従来のブレードダイシングによる品質の維持が困難な傾向にあります。当社独自の ML DICER を用いる事によりウェーハが薄くなっても高品質なダイシング品質が得られます。システムはインテグレーションされ、自動化され、薄いウェーハでも信頼性の高いハンドリングを可能にしています。

ACCRETECH CONSUMABLE

■ Grinding Wheel

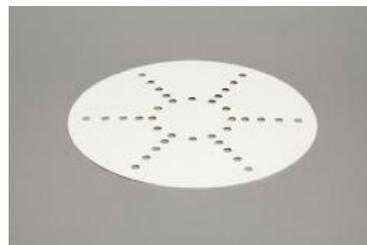


T D 2 0 0 0 K 2 - 3 W - 5 X - 3 0 0



■ Dressing Disk

- *TB325
- *TB2000



■ Polishing Pad

- *TP200V4 (For PG200)
- *TP300V4 (For PG300/PG3000)



■ Polishing Slurry

- *TS200L (Standard)
- *TS200H (Low contamination)
- *TS200S (High throughput)

株式会社東京精密

お問合せはお近くの取扱店まで

<http://www.accretech.jp/>

■ 半導体製造機器取扱営業所

東京営業所 Tel. (042) 631-5211 Fax. (042) 631-5234
 大阪営業所 Tel. (06) 6821-0361 Fax. (06) 6821-0210
 九州営業所 Tel. (096) 241-2101 Fax. (096) 386-1592

■ 半導体製造機器サービスステーション

仙台出張所 Tel. (022) 224-0177 Fax. (022) 224-7083
 山形出張所 Tel. (023) 631-5125 Fax. (023) 625-4129
 鶴岡出張所 Tel. (0235) 29-8020 Fax. (0235) 29-8022
 東京CE課 Tel. (042) 642-0358 Fax. (042) 642-0367
 東京CE課/土浦出張所 Tel. (0298) 34-8550 Fax. (0298) 31-6808
 四日市出張所 Tel. (0593) 61-6610 Fax. (0593) 66-2210

北陸出張所 Tel. (076) 422-6756 Fax. (076) 422-6757
 大阪CE課 Tel. (06) 6821-0225 Fax. (06) 6821-0210
 東広島出張所 Tel. (082) 493-5618 Fax. (082) 493-5619
 九州CE課 Tel. (096) 387-5188 Fax. (096) 386-1592
 九州CE課/大分出張所 Tel. (097) 534-3291 Fax. (097) 538-1989
 国分出張所 Tel. (0995) 43-2510 Fax. (0995) 43-2586
 八王子パーツセンター Tel. (042) 642-0381 Fax. (042) 642-0397

■ 東精エンジニアリング

土浦半導体工場 Tel. (029) 830-1882 Fax. (029) 832-5742
 土浦半導体工場/パーツセンター Tel. (029) 830-1882 Fax. (029) 832-5742